(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月4日(04.09.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/183035 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) *C11D 7/50* (2006.01)
C11D 7/32 (2006.01) *H01L 21/02* (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/006751

(22) 国際出願日： 2025年2月27日(27.02.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-030179 2024年2月29日(29.02.2024) JP
特願 2025-027562 2025年2月25日(25.02.2025) JP

(71) 出願人：花王株式会社(**KAO CORPORATION**) [JP/JP]；〒1038210 東京都中央区日本橋茅場町一丁目１４番１０号 (JP).

(72) 発明者：小受敦志(**KOKE Atsushi**).

(74) 代理人：弁理士法人池内アンドパートナーズ(**IKEUCHI & PARTNERS**)；〒5306026 大阪府大阪市北区天満橋１丁目８番３０号ＯＡＰタワー２６階 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能)：AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能)：ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：
一 国際調査報告（条約第21条(3)）

WO 2025/183035 A1

(54) **Title:** CLEANING AGENT COMPOSITION FOR WAFER PROCESSING

(54) 発明の名称： ウエハ加工用洗浄剤組成物

(57) **Abstract:** An embodiment of the present invention provides a cleaning agent composition for wafer processing, which has excellent removability of a wafer processing adhesive. An embodiment of the present disclosure relates to a cleaning agent composition for wafer processing for removing a wafer processing adhesive remaining on a wafer, wherein the cleaning agent composition contains a nitrogen-containing aprotic polar solvent (component A) having 2 to 10 inclusive carbon atoms and an organic amine (component B), the component A is a nitrile compound, and the value of the Hansen solubility parameter of a mixed solvent comprising the component A and the component B is 20.0 to 26.0 inclusive.

(57) 要約：一態様において、ウエハ加工用接着剤の除去性に優れるウエハ加工用洗浄剤組成物を提供する。 本開示は、一態様において、ウエハに残留するウエハ加工用接着剤を除去するための洗浄剤組成物であって、炭素数２以上１０以下である含窒素非プロトン性極性溶媒（成分Ａ）と有機アミン（成分Ｂ）とを含有し、成分Ａがニトリル化合物であり、成分Ａと成分Ｂからなる混合溶媒のハンセン溶解度パラメータ値が２０．０以上２６．０以下である、ウエハ加工用洗浄剤組成物に関する。